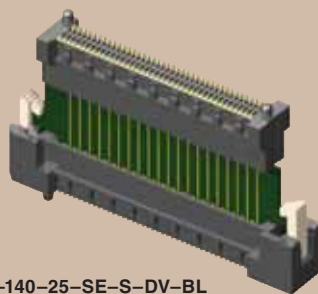
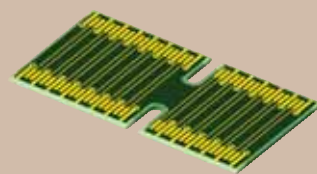


(0,80mm) .0315"

RU8, HSC8 系列



RU8-140-25-SE-S-DV-BL



HSC8-040-02-25-DP

加高型高速转接卡套件

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?RU8

连接器:
绝缘体材料:

黑色液晶
聚合物
触点: 镀铜
电镀: 在 50μ" (1,27μm)
的镍上镀金或锡
额定电流:
30°C 温升时为 3.1A
(详情参见网站。)
工作温度:
-55°C 至 +125°C

加工:

最大加工温度:
230°C 下持续 60 秒, 或
260°C 下持续 20 秒, 3 次
可无铅焊接: 是
SMT 引线共面性:
(0.10mm) .004" 最大 (40-60)
符合 RoHS 规范要求: 是



注: 有些长度、
式样和选项为
非标准型,
不可退换。



支持的
协议

PCI Express®
XAUI, SATA

登录 www.samtec.com/appnote
下载应用程序注释
与 SIG @ samtec.com 联系
了解有关协议的问题

RU8 - 1 - 每排位置数 - 堆叠高度 - 信号路由 - 电镀选项 - DV - BL - 其他选项

40, 50, 60

-19

= (19mm) .748"

-25

= (25mm) .984"

-30

= (30mm) 1.180"

-SE

= 单端

-DP

= 差分对

-S

= 触点镀 30μ"
(0.76μm)
的金,
焊尾镀雾锡
(连接器的电镀)
卡的电镀
为硬质金。

-BL

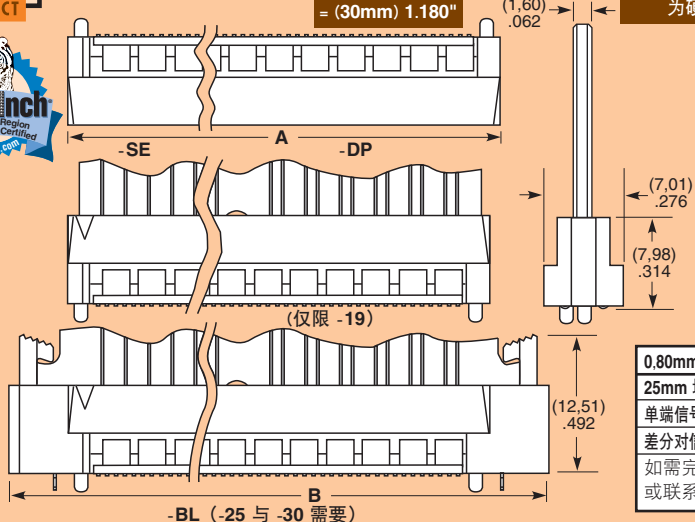
= 板
锁
(仅限底部
插口)
(-19 堆叠高度上
不提供)

对货盘, 保留
空白

-K
= (5.50mm)
.217" 直径的
聚酰亚胺膜
取
放垫

-TR
= 卷带封装

套件包含两个连接器
和一张卡。需要组件。



每侧位置数	A	B	-SE 信号线路总数	-DP 信号对总数
40	(39.80) 1.567	(50.39) 1.984	40	26
50	(47.80) 1.882	(58.39) 2.299	50	32
60	(55.80) 2.197	(66.40) 2.614	60	38

0.80mm 间距 RU8	在 -3dB 插入损耗的额定值
25mm 堆叠高度	
单端信号	7.5 GHz/15 Gbps
差分对信号	7.5 GHz/15 Gbps
如需完整测试数据, 请浏览 www.samtec.com?RU8 或联系 sig@samtec.com	

配接:
HSEC8

技术规格

若需要完整的技术规格, 请浏览 www.samtec.com?HSC8

导体:

1/2 oz 铜

触点区域:

镀硬质金

绝缘体: FR-4

符合 RoHS 规范要求: 是

每侧位置数	-SE 信号线路总数	-DP 信号对总数
-040	40	26
-050	50	32
-060	60	38

注: 某些尺寸、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

HSC8

每侧位置数

卡式样

堆叠高度

信号路由

-040, -050, -060

-02

= (1.60mm)

.062"

厚度的卡

-19

= (19mm)

.748"

-25

= (25mm)

.984"

-30

= (30mm)

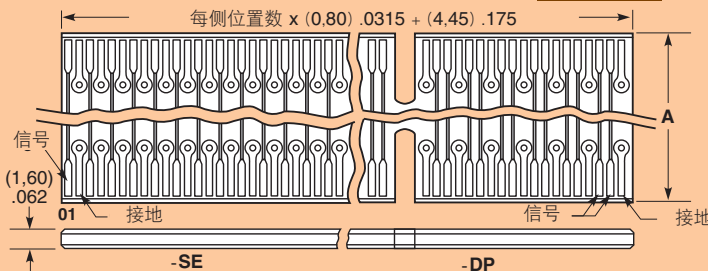
1.180"

-SE

= 单端

-DP

= 差分对



堆叠高度	A
-19	(14.84) .584
-25	(20.84) .820
-30	(25.84) 1.017